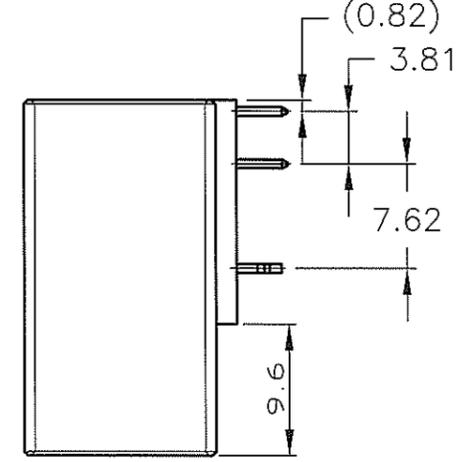
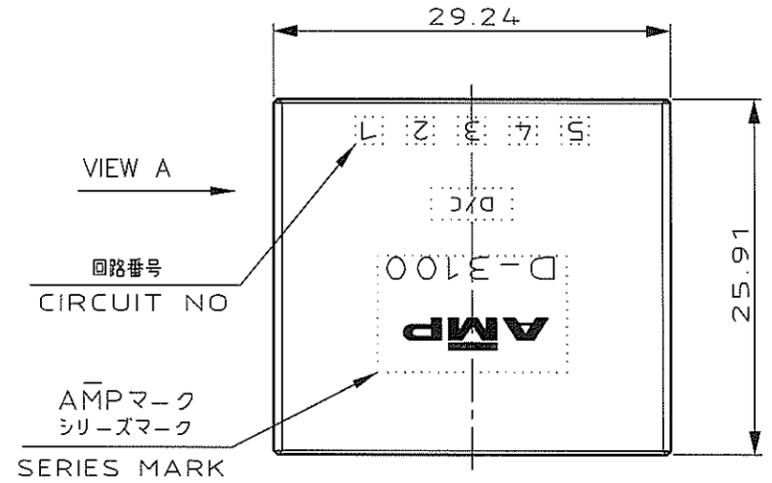
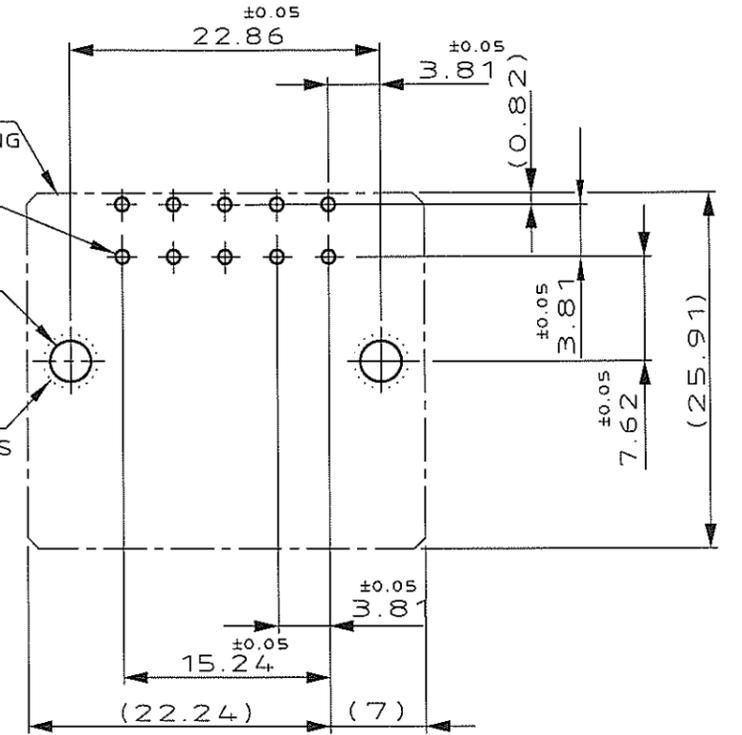


NUMBER 178305  
 METRIC  
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST

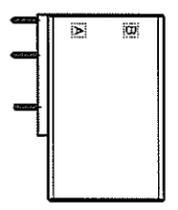
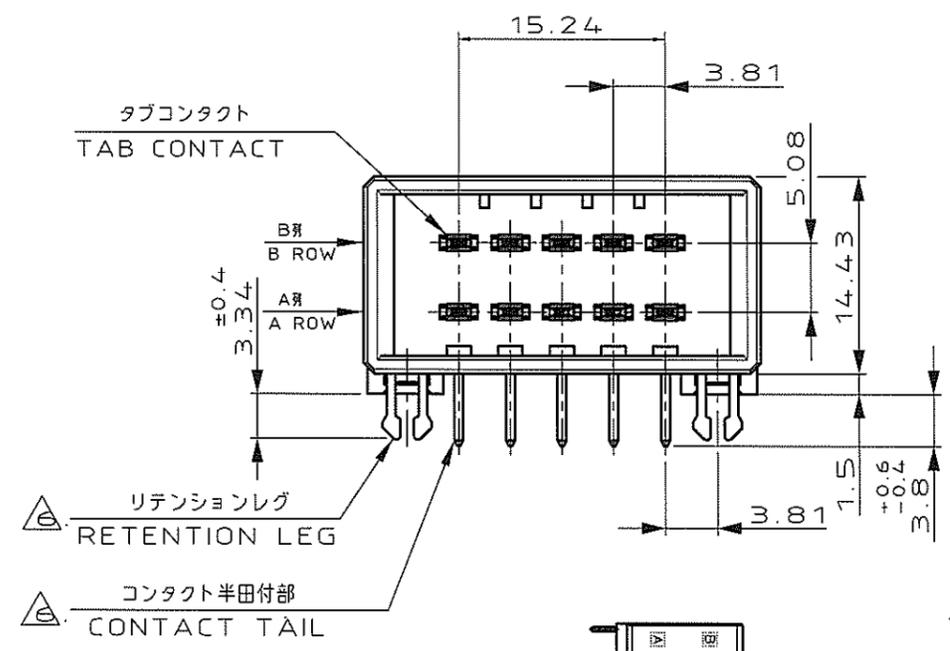


コネクタ外形  
 OUTLINE OF HEADER HOUSING  
 10-φ1.1 ±0.1  
 DIA 1.1±0.1 10PLACES  
 スルーホール 2-φ3 ±0.1  
 DIA 3±0.1 2PLACES  
 ラウンド 2-φ4 MIN  
 ROUND DIA 4 MIN 2PLACES



推奨基板取付け寸法  
 PC 基板厚: 1.6±0.1  
 (非累積公差)  
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN  
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1  
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)  
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)



VIEW A  
 (SCALE: 1:1)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂  
 コネクタ: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
- めっき: コネクタ: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部: ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178305-5
△5	△3	178305-3
△6	△2	178305-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	25APR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME		
mm²(AWG)		mm		ダイナミック D3100 水平タイプ 10 極 ヘッダーアセンブリー		
MATERIAL		FINISH		10 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100		
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		
DR. 14 JUN 91 N. Matsubara		DE. 14 JUN 91 N. Matsubara		SIZE	LOC	NUMBER
CHK. 24/FEB/92 H. Oota		APP. L/MAR/92 S. MANABE		A3	J	C-178305
				SCALE	REV.	SHEET
				2-1	C2	1 OF 1